

2021年1月25日

各位

住 所 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号  
 会 社 名 ジオマテック株式会社  
 代 表 者 代表取締役社長兼CEO 松崎 建太郎  
 (JASDAQ コード: 6907)  
 問合せ先 取締役執行役員兼CFO 河野 淳  
 電話番号 045-222-5720

三井金属鉱業株式会社と共創・協働で量産体制を整えている次世代半導体チップ  
 実装用特殊ガラスキャリア「HRDP<sup>®</sup>」の量産出荷開始に関するお知らせ

当社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長 松崎 建太郎)は、三井金属鉱業株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長 西田 計治、以下「三井金属」)が事業化を推進している次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP<sup>®</sup>※1」に薄膜を提供しております。

この度、国内の複合チップモジュールデバイスメーカー様向けに「HRDP<sup>®</sup>」の量産出荷が始まりましたので、お知らせいたします。

当社は、2018年1月25日に三井金属が開発したRDL 1st工法※2によるファンアウト・パネルレベルパッケージ用ガラスキャリア付き微細回路形成材料「HRDP<sup>®</sup>」へ薄膜を提供する旨をお知らせいたしました。

この度、三井金属は、国内の複合チップモジュールメーカー様に対し、2021年1月より「HRDP<sup>®</sup>」の出荷を開始いたしました。このお客様では、RFモジュール※3を始め、今後拡大する5G市場向けデバイスやその他さまざまな用途向けのデバイスを「HRDP<sup>®</sup>」で製造し、販売を拡大していく計画です。

また、2021年度中には海外の大手実装メーカー様において採用が予定されていることに加え、2022年度以降は、HPC※4やモバイル等多様なアプリケーション用途の量産開始が計画されており、当社が薄膜を提供している「HRDP<sup>®</sup>」のさらなる市場拡大が見込まれます。

当社は三井金属と共創・協働し、お客様の声を形にして、安定した品質と十分な供給能力を確保するとともに、価値ある薄膜と加工技術を提供するプロフェッショナルとして、さらなる市場拡大に努めてまいります。

以上

本件に関するお問い合わせ

三井金属鉱業株式会社 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部  
 TEL 03-5437-8028  
 E-mail [PR@mitsui-kinzoku.com](mailto:PR@mitsui-kinzoku.com)

ジオマテック株式会社

TEL 045-222-5720  
 E-mail [ir\\_geomatec@geomatec.co.jp](mailto:ir_geomatec@geomatec.co.jp)

【用語説明】

※1 High Resolution De-bondable Panel の略

※2 Re-Distribution Layer 1st 工法: 再配線層を形成した後、半導体チップ実装を行う工法

※3 Radio Frequency Module: 複数の能動部品(ICチップ)と受動部品(SAW、コンデンサ、抵抗、コイル)を搭載し、封止した製品

※4 High Performance Computing: 大規模で極めて高速な計算処理能力を有するコンピュータ